

图书基本信息

书名：<<大学校区科技园区公共社区联动发展>>

13位ISBN编号：9787807450696

10位ISBN编号：780745069X

出版时间：2007-8

出版时间：7-80745

作者：李建强

页数：231

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

大学校区、科技园区和公共社区的“三区联动”不仅是校区、园区、社区空间层面的整合，而且是一个复杂的系统整合过程，涉及区域创新体系建设、城市增长方式转变、高校布局结构调整与科教体制改革、城区功能定位与产业升级、和谐社区建设以及郊区城市化方式等诸多重要问题，是能够“撬动”城市创新发展全局的战略支点。

书籍目录

绪论第1章 “三区联动”的理论基础1.国内外研究动态回顾2.本书研究的理论框架第2章 模式机制与系统设计1.上海不同模式“三区联动”实践的动力机制比较与弊端2.三区联动机制的归纳3.三区联动发展的整体系统设计第3章 “三区联动”的侧度与评估1.创新活动的评价经验2.“三区联动”评价指标体系构件原则第4章 “三区联动”视觉下的其他国家或地区区域创新实践1.美国硅谷的发展及其启示2.韩国大德科技园区的发展及其启示3.台湾地区新竹科学工业园区的发展及其启示4.其他国家或地区联动实践中的共同特点与类型分析第5章 上海案例研究：以校区为视觉第6章 上海案例研究：以园区为视觉第7章 上海案例研究：以社区为视觉第8章 “三区联动”的问题与对策参考文献后记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>